



# Technical Data Sheet

## FeedBond® AP-80-S Series

### 熱固型導熱吸波膠

#### A. 產品說明

是一種高性能單組份可熱固化的有機矽膠，是為 IC 封裝和散熱器應用而開發，具有高導熱性、良好的熱穩定性，還可抑制或吸收電子設備的雜訊輻射問題，AP-80-S 系列同時兼具優異的導熱和吸波性能。

#### B. 產品特性

- 無添加溶劑
- 適用於點膠作業
- 高導熱性滿足 IC 高功率的應用性
- 在寬頻率範圍內具有良好的 EMI 抑制

#### C. 產品應用

- 性能優勢來自導熱性和降低 EMI 的雙重功能特性。
- EMI 降低，信號完整性更好，提高電子產品的可靠性。
- 產品的溫度穩定性和低揮發特性，電子產品的性能穩定。
- 符合 RoHS 和 REACH 等法規要求。

#### D. 產品規格

##### 硬化前特性

產品編號	外觀	操作時間 hrs	黏度 @25°C cps	搖變指數 T.I.
測試方法	目視	FT-P024	FT-P006	FT-P008
AP-80-S01	灰色	10	5,000	4.4
AP-80-S02			6,500	4.3
AP-80-S03			7,000	4.2
AP-80-S04			11,000	2.8
AP-80-S05			18,000	2.6
AP-80-S06			20,000	2.5
AP-80-S07			24,000	2.4



硬化後特性

產品編號	外觀	比重	硬度 Type 00	熱傳導係數 W/mK	電阻 Ω	工作溫度 °C
測試方法	目視	FT-P001	FT-P037	Hot Disk <sup>1</sup>	電阻計	NA
AP-80-S01			20	5.0	$> 10^{11}$	-40 ~ 125
AP-80-S02			22	9.0	$> 10^{11}$	-40 ~ 125
AP-80-S03			25	12.0	$> 10^{11}$	-40 ~ 125
AP-80-S04	灰色	2.3	40	13.0	$> 10^5$	-40 ~ 125
AP-80-S05			43	14.0	$< 10^3$	-40 ~ 125
AP-80-S06			49	14.5	$< 10^3$	-40 ~ 125
AP-80-S07			54	15.0	$< 10^3$	-40 ~ 125

1. Hot Disk : Sensor 5501、Slab model。

硬化條件

標準硬化條件

測試條件

烘箱烘烤 125°C/90 分鐘

或

烘箱烘烤 150°C/60 分鐘

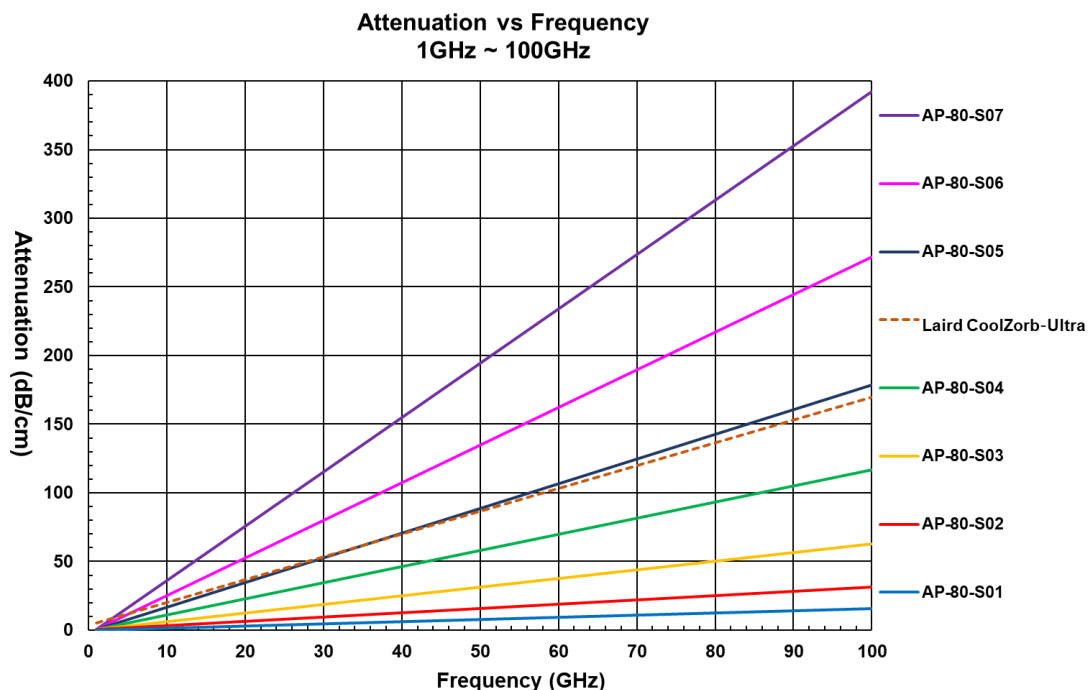
包裝和貯存條件

包裝 50gm (針筒)

貯存條件 -40°C，可保存 3 個月

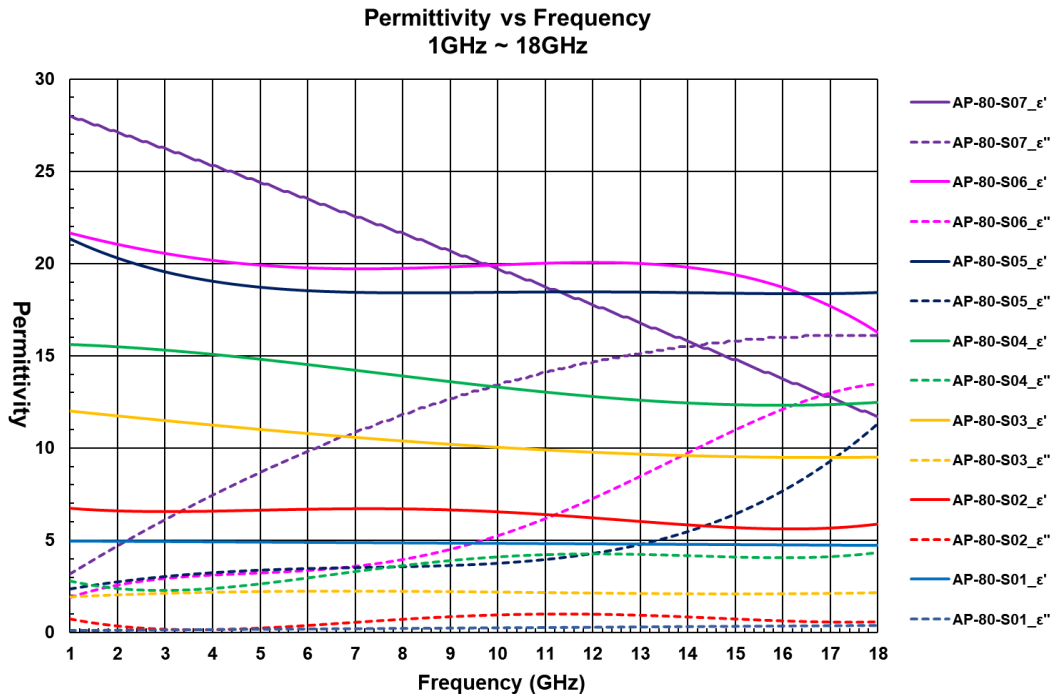
此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

E. Attenuation 1GHz ~ 100GHz :





## F. Permittivity 1GHz ~ 18GHz:



## G. 使用指導方針

1. 表面必須清潔乾淨。
2. 白金觸媒會與某些化合物形成錯體，阻礙觸媒作用，導致硬化不良。
3. 如果基材抑制固化的能力未知，則應進行小規模測試以確定相容性。
4. 避免下列物質：
  - ① 有含N、P、S等有機化合物
  - ② Sn、Pb、Hg、Sb、Bi、As等重金屬的離子(ion)性化合物
  - ③ 含有乙炔基(acetylene)等不飽和基的有機化合物

## H. 運輸

運送過程皆放入低溫冰袋等低溫保存以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無冰塊殘留，請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

## I. 回溫解凍

解凍時將容器垂直放置，直到完全達室溫時才能使用，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

## J. 貯存

當您收到貨品時，請立即以低溫儲存@ -40°C，由於不同溫度下之保存將影響產品的保存期限。

## K. 包裝

包裝為依照客戶需求選擇針筒或塑膠罐包裝，如需要詳細資料請聯絡 Feedpool 客戶服務及銷售部門。